Ossidi per ottica ed elettronica: relazioni tra proprietà microscopiche ed applicazioni



> Materiali ed applicazioni del SiO₂

> Preparativa e proprietà microscopiche

> Conclusioni

Materiali ed applicazioni del SiO₂

> Preparativa e proprietà microscopiche

> Conclusioni

Applicazioni del SiO2



Vetri di alta purezza per applicazioni di ottica e fotonica

Fibre ottiche per telecomunicazioni e sensori





Materiali isolanti in dispositivi MOS

I materiali di alta purezza

SiO_2 amorfa = Silice



(Contenuto di gruppi OH) \leq 1000 ppm in peso

(Contenuto di altri elementi differenti da Si ed O) < ppm in peso



Indice di rifrazione n $\approx 1.4 \div 1.6$

Elevata trasmissione nel visibile e nell'UV (>90%)

La presenza dei gruppi OH riduce la trasmissione nell'IR

Elevato potere isolante

I materiali di alta purezza



I materiali di alta purezza

Nelle fibre ottiche si utilizza SiO₂

Tipicamente i segnali trasmessi sono in una regione di lunghezze d'onda corrispondente ad una delle seguenti "finestre per le telecomunicazioni": •Prima finestra: 800–900 nm.

•Seconda finestra : lunghezze d'onda intorno a 1300 nm (1.3 μm).

•Terza finestra : lunghezze d'onda intorno a 1500 nm (1.5 μm).

Le perdite per assorbimento sono minime in quest'ultima regione, e sono disponibili amplificatori su fibra drogata con erbio che offrono la possibilità di estendere le distanze di trasmissione.

Band	Description	Wavelength range		
O band	original	1260–1360 nm		
E band	extended	1360–1460 nm		
S band	short wavelengths	1460–1530 nm		
C band	conventional ("erbium window")	1530–1565 nm		
L band	long wavelengths	1565–1625 nm		
U band	ultralong wavelengths	1625–1675 nm		

Fibre ottiche





La trasmissione su OF è basata sul fenomeno della riflessione totale

 $n_{core} > n_{cladding}$

 $\alpha > \alpha_{\text{limite}} = \text{arcsen} (n_{\text{clad}} / n_{\text{core}})$

Il valore dell'indice di rifrazione viene modificato attraverso l'inserimento di droganti (Ge, P, F, CI) nel SiO2

I materiali drogati

Ge:SiO₂

Contenuto di Ge ~1÷10% Disperso e sostituzionale





Introduzione di livelli energetici spuri all'interno della gap

Fotosensibilità: variazioni dell'indice di rifrazione indotte da esposizione a luce laser

 $\Delta n \approx 10^{-4} \div 10^{-3}$

Fiber Bragg Grating

Un reticolo di Bragg in fibra è una perturbazione periodica o pseudoperiodica dell'indice di rifrazione del core di una fibra ottica





Un FBG è un filtro spettrale selettivo che riflette una banda della radiazione in ingresso intorno alla lunghezza d'onda di Bragg

$$\lambda_{\text{Bragg}} = 2n\Lambda$$

Es. : λ_B = 1.5 µm per Λ = 0.5 µm

FBG come sensori



Fiber Lasers



Setup of a simple fiber laser. Pump light is launched from the left-hand side through a dichroic mirror into the core of the doped fiber. The generated laser light is extracted on the right-hand side



A simple erbium-doped femtosecond laser, where the Fresnel reflection from a fiber end is used for output coupling I Fiber lasers (P = 1 mW ÷ 100W) impiegano fibre ottiche come mezzo attivo

Si utilizza una fibra di SiO₂ drogata con ioni delle terre rare come erbio (Er³⁺), neodimio (Nd³⁺), itterbio (Yb³⁺), tulio (Tm³⁺), o praseodimio (Pr³⁺), ed impiegando diodi laser per il pompaggio



Level scheme of thulium (Tm³⁺) ions in ZBLAN fiber, showing how excitation with an 1140-nm laser can lead to blue fluorescence and laser emission

lon	Common host media	Important emission wavelengths		
<u>neodymium</u> (Nd ³⁺)	YAG, <u>YVO</u> ₄, <u>YLF</u> , <u>silica</u>	1.03–1.1 μm, 0.9–0.95 μm, 1.32–1.35 μm		
<u>ytterbium</u> (Yb ³⁺)	YAG, <u>tungstates</u> , <u>silica</u>	1.0–1.1 μm		
erbium (Er ³⁺)	YAG, <u>silica</u>	1.5–1.6 μm, 2.7 μm, 0.55 μm		
thulium (Tm³+)	YAG, <u>silica</u> , <u>fluoride</u> glasses	1.7–2.1 μm, 1.45–1.53 μm, 0.48 μm, 0.8 μm		
holmium (Ho ³⁺)	YAG, YLF, <u>silica</u>	2.1 μm, 2.8–2.9 μm		
praseodymium (Pr ³⁺)	eodymium (Pr ³⁺) <u>silica</u> , fluoride glasses			
corium (Co3+)	YLF, LiCAF, LiLuF, LiSAF, and similar	0.28, 0.22,		
	fluorides	υ.20-0.55 μπ		

Photonic crystal fibers: PCF



Photonic crystal fibers: PCF



Photonic crystal fibers: PCF







> La purezza e la stechiometria del SiO₂ condizionano l'uso del materiale

> La presenza di trappole di carica (difetti di punto) nell'ossido di gate ne modifica le proprieta' dielettriche e causa il malfunzionamento del dispositivo.

 Fasi di produzione o esposizione a radiazioni ionizzanti (UV, raggi X, γ, β) inducono trappole di carica



Miniaturizzazione







Miniaturizzazione



La miniaturizzazione dei componenti ha portato alla costruzione di strati di SiO_2 (isolante del gate nei MOSFET) dello spessore di pochi nm

SiO₂

MOSFET a dimensione ridotta

I MOSFET con lunghezze di canale molto minori del micrometro sono una sfida per la tecnologia. Negli anni recenti si è arrivati a poche decine di nanometri (35 nm) creando problemi operativi



FET

PROBLEMI

Conduzione sotto soglia maggiore

A causa delle ridotte dimensioni, il voltaggio che può essere applicato al gate deve essere ridotto

Aumento delle perdite gate-ossido

L'ossido di gate, che funge da isolante tra gate e canale, dovrebbe essere reso il più sottile possibile per aumentare la conducibilità nel canale e le prestazioni del transistor.

Tuttavia, con l'attuale spessore dell'ossido di gate in SiO_2 (circa 1.2 nm, che in atomi di silicio è pari a ~ 5 atomi) il fenomeno quantistico di effetto tunnel di elettroni che si verifica tra il gate ed il canale provoca un aumento del consumo di energia.



Miniaturizzazione



MOSFET a dimensione ridotta

Isolanti che hanno una costante dielettrica più grande del biossido di silicio (denominati dielettrici ad alta-k), come metallo-silicati del gruppo IV, ad esempio silicati di afnio o di zirconio, ed ossidi di afnio o zirconio (afnia e zirconia) sono utilizzati per ridurre le perdite del gate nella tecnologia dai 45 nanometri in poi. Aumentare la costante dielettrica del dielettrico di gate consente di aumentarne lo spessore, pur mantenendo un'alta capacità fissate tutte le altre geometrie. Un più alto spessore dielettrico riduce la corrente di tunneling attraverso il dielettrico tra il gate e il canale.



In base alla stabilità termodinamica HfO_2 è risultato il materiale più adatto sul Si



I difetti nel materiale creano livelli energetici elettronici all'interno della gap

Le cariche che vi si intrappolano possono cambiare la V_T

I difetti possono indurre instabilità temporale dei dispositivi

I difetti possono fare da precursori per il "breakdown"

Le cariche intrappolate possono divenire centri di scattering per gli elettroni in transito nel canale

Nanostrutture in SiO_2



FIG. 2. HREM image (upper part, cross section; lower part, plan view) of nanocrystals on SiO₂ J_{Ge} =0.08 ML/s, T=250 °C.

APPLIED PHYSICS LETTERS 90, 133120 (2007)

Pulsed ion-beam induced nucleation and growth of Ge nanocrystals on SiO₂

N. P. Stepina,^{a)} A. V. Dvurechenskii, V. A. Armbrister, V. G. Kesler, P. L. Novikov, A. K. Gutakovskii, V. V. Kirienko, and Zh. V. Smagina Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, prospekt Lavrent'eva 13, 630090 Novosibirsk, Russia

R. Groetzschel Forschungszentrum Rossendorf, D–01328 Dresden, Germany

Nanocrystals (NCs) in a dielectric matrix have attracted much attention as a promising candidate for a charging nodes in a single-electron memory device (SEMD). An advantage of the nanofloating gate memory over the continuous floating gate is its improved endurance due to preventing lateral charge movement. Faster writing/erasing time, lower operating voltage, and longer retention time have been demonstrated in memory device based on Si NCs embedded in SiO₂.^{1,2} Recently, King *et al.* showed that Ge-based SEMD has the superior properties over Si-based SEMD in terms of the writing/erasing time and the operating voltage.³ Since then different methods were used for fabrication of Ge NCs in dielectric matrix, such as ion-beam synthesis,⁴ oxidation and reduction of Ge/Si NCs,5 rapid thermal annealing of cosputtered,⁶ molecular beam epitaxy deposited,⁷ and chemical-vapor deposited³ layers, and pulsed-laser deposition.⁸ However, space distribution of NCs within dielectric created by most of these techniques is random. To suppress the tunneling distance fluctuation, one should form in-plane distribution of NCs. Moreover, when using NCs for charge storage devices, the general requirements that can be placed upon the control are the size of NCs and their density and homogeneity in growth plane. That is the problem for most of the above-mentioned growth methods. Our prelimi-

Nanostrutture in SiO_2 : Semiconduttori

Il campo di ricerca delle nanostrutture (cluster) in silice e di silice si è rivelato promettente nella tecnologia delle telecomunicazioni e dei dispositivi su scala quantistica per applicazioni ottiche non-lineari.

Il piccolo numero di atomi che formano i cluster e la rilevante frazione di atomi sulla superficie del cluster rendono questi oggetti intrinsecamente differenti dalla fase bulk in termini sia di proprietà fisiche sia chimiche.

> Si-a Ge=NC Si0₂ Si(001) 3.3Å Ge-NC 30 nm

Per esempio, il valore della regione di energie proibite (gap) tra banda di valenza e di conduzione può essere modulato attraverso la variazione delle dimensioni dei cluster. Questa è una manifestazione dell'effetto di confinamento quantistico che avviene quando il diametro del cluster è minore delle dimensioni del raggio di Bohr (raggio atomo idrogenoide) dell'eccitone libero: tipicamente qualche nm.

Questi sistemi sono usualmente riferiti come *punti quantici* (*quantum dots*). In linea di principio, le proprietà fisiche del sistema nonostrutturato possono essere regolate finemente ed adattate per ottenere materiali con caratteristiche predefinite



Nanostrutture in SiO₂: Isolanti



FIG. 1. TEM image of tin dioxide nanoclusters dispersed in SiO_2 in a glass-ceramic sample prepared by the sol-gel technique.



FIG. 2. HRTEM images of 2 mol % SnO_2 -doped silica, showing the structural features of the crystalline nanophase; the upper inset shows a magnification of the image of a single SnO_2 dot 5.6 nm in diameter in (001) projection with the measured lattice parameters; the lower inset shows the corresponding ED pattern.

Nanostrutture di SiO₂







Fig. 1. Hybrid organic-inorganic materials containing organic chromophores prepared at the Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (Ecole Polytechnique) [10].

Fig. 1 An overview of the versatility of the fluorescent core-shell silica nanoparticle platform: illustrations of single and dual-emission particles as well as gold-nanoshell encapsulated core-shell particles are shown at the heart of the figure, while a variety of applications including bioimaging, drug delivery, sensing and therapeutics are shown in the periphery.

> Materiali ed applicazioni del SiO₂

> Preparativa e proprietà microscopiche

> Conclusioni

SiO₂

directly below it in the table. Controversy about silicon's character dates to its discovery. It was first prepared and characterized in pure form in 1823. In 1808, it was given the name silicium (from Latin: *silex*, hard stone or flint), with an **-ium** word-ending to suggest a metal, a name which the element retains in several languages. The present English name was first suggested in 1817 to conform with the physically similar elements, carbon and boron.

Silicon is the eighth most common element in the universe by mass, but very rarely occurs as the pure free element in the Earth's crust. It is most widely distributed in dusts, sands, planetoids, and planets as various forms of silicon dioxide (silica) or silicates. Over 90% of the Earth's crust is composed of silicate minerals, making silicon the second most abundant element in the Earth's crust (about 28% by mass) after oxygen.^[9]

Most silicon is used commercially without being separated, and often with little processing of the natural minerals. Such use includes industrial construction with clays, silica sand, and stone. Silicate is used in Portland cement for mortar and stucco, and mixed with silica sand and gravel to make concrete for walkways, foundations, and roads. Silicates are used in whiteware ceramics such as porcelain, and in traditional quartz-based soda-lime glass and many other specialty glasses. Silicon



Il biossido di silicio amorfo: $a-SiO_2$, o silice

Silice

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **silice** /silice/ (o anche **anidride silicica**, IUPAC **biossido di silicio**) è un composto del silicio la cui formula chimica è SiO₂.

La silice purissima per applicazioni ad alta tecnologia viene ottenuta dalla reazione in fiamma fra il tetracloruro di silicio e l'ossigeno

 $SiCl_4 + O_2 \rightarrow SiO_2 + 2Cl_2$,

e a seconda del contenuto finale di gruppi OH, la silice viene comunemente distinta in silice dry e silice wet (rispettivamente, basso o elevato contenuto di gruppi OH).

Pura, è una polvere cristallina bianca che impartisce all'acqua una lieve acidità: una sospensione di 40 g in un litro di acqua ha pH compreso tra 3,7 e 4,7.

Lo stato fisico più comune in natura è quello solido cristallino, in minerali come il quarzo e i suoi polimorfi, e più raramente quello amorfo, come nell'opale; la silice cristallina è il costituente principale di diverse rocce sedimentarie (ad es. sabbia, radiolariti, quarzareniti e pelle di leopardo). Talvolta si rinviene cristallizzata da fluidi di segregazione all'interno di rocce metamorfiche e magmatiche e all'interno di rocce carbonatiche sotto forma di selce di origine metasomatica.

Moltissimi animali e piante utilizzano la silice presente come ione silicato sia nell'acqua dolce sia in quella salata purché al di sotto dei 18 °C. Le diatomee, i radiolari, le spugne silicee, moltissimi cereali ed altre piante come la canna da zucchero e l'equiseto utilizzano questo materiale come impalcatura per lo sviluppo di strutture scheletriche.

Esistono comunque anche 15 solidi cristallini composti esclusivamente di silice, tra i quali il più famoso è certamente il quarzo o le sue forme di alta e altissima temperatura tridimite e cristobalite, oltre a solidi criptocristallini quali il calcedonio.



Il biossido di silicio amorfo: $a-SiO_2$, o silice



Fig. 1 The relative abundance of elements in the earth's crust illustrates the common availability of quartz and the silicas [1]

Il biossido di silicio amorfo: $a-SiO_2$, o silice



Classificazione Acqua Oligominerale

\$102

SILICE

26,43 mg/l

Water temp, at spring	11,6°C
Conductivity 20°C	100u\$/cm
(Ph)	6,6
Residue 180°	70 mg/
Ammonium	<0.03 mg/l
Nitrites (NQ2)	<0,002 mg/l
Nitrali (NO0)	2,70 mg/l

at many many many many second at	A REAL PROPERTY AND		
CALCIUM	CA++	3,60 mg/	
SODIUM	NA:	0,013 g/	
MAGNESIUM	Mg++	4,60 mg/	
POTASSIUM	K ⁺	0,23 mg/l	
BICARBONATE	HCO3	42.70 mg/l	κ.
SULPHATE	SO4	4.86 mg/	
CHLORIDE	CL	3.90 mg/j	
SICON	SIO2	26,43 mg/l	

Silice						
Nome IUPAC						
diossido di	i silicio					
Caratteristich	e generali					
Formula bruta o molecolare	SiO ₂					
Peso formula (u)	60,08					
Aspetto	solido cristallino bianco					
Numero CAS	[7631-86-9]					
Proprietà chimico-fisiche						
Densità (g/cm ³ , in c.s.)	2,2					
Solubilità in acqua	0,15 g/l a 298 K					
Temperatura di fusione (K)	1999 (1726 °C)					
Proprietà termochimiche						
∆ _f H ⁰ (kJ·mol ⁻¹)	-910,7					
Δ _f G ⁰ (kJ·mol ^{−1})	-856,3					
S ⁰ m(J·K ⁻¹ mol ⁻¹)	41,5					
$C_{p,m}^{0}(J\cdot K^{-1}mol^{-1})$	44,4					



Figure 2 – Details of a SiO₄ tetrahedron in right α -quartz (See Fig. 1). Symbols $a_{<}$ and $a_{>}$ locate possible sites for an interstitial atom/ion in the middle of a large c-axis channel at its intersection with the two-fold axis $a_1 = x$ -axis. Symbols \pm give the sign of the electrical charge developed on a_1 when the crystal is compressed along this direction (– charge on + side of a_1). Reproduced from Fig. 7 of [6].

SiO₂



SiO₂



Figure 1. Zachariasen's original random network diagram (retraced) for a glass of composition A₂O₃ [8], with structural units shaded to indicate range I, II and III order. Small atoms, A and large atoms, O. Note the regularity of the AO₃ structural units.

Polymorph/Regrowth	Avg. Si-O-Si Angle θ ,°	Avg. Ring Size	Avg. Local Cluster Size	Density, ×10 ³ kg/m ²	
HP-Tridymite	149.5	6	27	2.18*	
β-Cristobalite	148.0	6	29	2.21*	
α -Cristobalite	145.3	6	29	2.33*	
Keatite	154.1	6.9	39	2.50*	
α-Moganite	138.5	7.4	41	2.62*	
α -Quartz	143.6	7.7	63	2.65*	
β-Quartz	150.9	7.7	63	2.77*	
Coesite	150.8	10.0	78	3.01*	
Vitreous Silica	145	~6	?	2.21*	

Cristobalite	high temperature (1743-2001 K)	α 2.33 β 2.21	12 6-rings
Tridymite	high temperature (1140-1743 K)	HP 2.18 MC 2.26	12 6-rings
Vitreous Silica	high temperature (Tg~ 1333 K)	2.21	n ≈ 6?

In "Defects in SiO_2 and related dielectrics: Science and Techn." Ed. G.Pacchioni, L.Skuja, D.L. Griscom, Kluwer 2000



C. Koike et al. The Astroph. Journ. (2013) 778, 60

http://www.quartzpage.de

Produzione di SiO₂











By varying the concentration of the coreactants, the flame temperature, and the dwell time of the silica in the combustion chamber, it is possible to influence the particle size, the particle size distribution, the specific surface, and the surface properties of the silicas within wide boundaries.

SiO_2 sol-gel



SiO₂ nanostrutturata

Polveri nanostrutturate di Si O_2

> Preparazione attraverso la tecnica sol-gel a temperatura ambiente: idrolisi e condensazione di tetraetoxisilano (TEOS) o tetrametoxisilano (TMOS)

> Preparazione di polveri nanostrutturate fumed silica: idrolisi di SiCl₄

Superficie specifica maggiore di 400 m²/g

L'auto aggregazione delle particelle è un attrattiva di notevole interesse per costruire nanostrutture. Particelle di silice nanoporosa sono di dimensioni dell'ordine del micrometro (1/10 di un capello umano), e posseggono canali di dimensioni nanometriche.

Produzione di SiO_2

Aerosil							
	OX 50	90	130	150	200	300	380
Diametro particella primaria (nm)	40	20	16	14	12	7	7
Superficie specifica (m²/g)	50	90	130	150	200	300	380

Average diameter of the primary particles [nm] Superficie specifica (superficie/massa)



 $\frac{\text{Superficie}}{\text{Volume}} \propto \frac{1}{r}$

SiO_2 nanostrutturata





SiO₂ nanostrutturata





FIG. 1. (a) The sintering process for the disk shaped samples; heating times are indicated below the respective samples. (b) A photograph of photoluminescent silica glass, which was prepared by heating fumed silica at 980 °C for 168 h, excited with a pulsed Nd:YAG laser light (λ_{exc} =266 nm; \sim 3 mJ/cm² per pulse). A bright part corresponds to the irradiated area with the laser (beam diameter ~10 mm).

SiO₂ nanostrutturata



Figure 10. Schematic atomic arrangements of (a) a non-heat-treated sample with open pores, (b) a heat-treated sample with macroscopic enclosed pores, and (c) a heat-treated sample with no macroscopic enclosed pores. Broken lines represent hydrogen bonds. The Si atoms involved in and derived from the edge-sharing tetrahedral units are circled in (b) and (c), respectively. The shaded part in (c) indicates the region in which the interfacial atomic arrangements are not fully relaxed and are hence highly deformed.

Struttura delle particelle di SiO₂ nanometrica



Figure 7: Schematic representation of the formation of fumed silica primary particles: SiCl₄ hydrolysis in H_2/O_2 flame a), formation of small SiO₂ clusters b) and, finally, the primary particle c). The shell model of this latter with a core and surface region is shown. The rings distribution of small clusters, bulk silica, core and surface shells primary particle, are qualitatively reported.

SiO_2 nanostrutturata



SiO_2 nanostrutturata



SiO₂ nanostrutturata

Proprietà di emissione di nanoparticelle di silice





Fig. 1. (a) Contour plot of the emission spectra collected at various E_{ex} ranging from 2.25 to 5.90 eV with $\Delta T = 200$ ns and $T_D = 3$ ns; the dashed line represents $E_{em} = E_{ex}$. (b) PL spectra detected under different E_{ex} indicated by the arrows, the scattered laser light is also evident in the tails at high energies. (c) Excitation energy dependence of the PL amplitude measured at the peak of each spectrum.

Processo di diffussione in SiO₂ nanostrutturata





Fig. 1. Schematic diagram of low-lying electronic states and electronic transitions of interstitial O_2 in a-SiO₂.

Nature Nanotechnology **4**, 710 - 711 (2009) doi:10.1038/nnano.2009.326

Subject term: Nanomedicine

Bioimaging: Second window for *in vivo* imaging

Andrew M. Smith¹, Michael C. Mancini¹ & Shuming Nie¹

1. Andrew M. Smith, Michael C. Mancini and Shuming Nie are in the Departments of Biomedical Engineering and Chemistry, Emory University and Georgia Institute of Technology, 101 Woodruff Circle Suite 2007, Atlanta, Georgia 30322, USA.

Correspondence to: Shuming Nie¹ e-mail: <u>snie@emory.edu</u>

Enhanced fluorescence from carbon nanotubes and advances in near-infrared cameras have opened up a new wavelength window for small animal imaging.

Near-infrared light (700–2,500 nm) can penetrate biological tissues such as skin and blood more efficiently than visible light because these tissues scatter and absorb less light at longer wavelengths. Simply hold your hand in sunlight and your fingers will glow red owing to the preferential transmission of red and near-infrared light.



MESOPOROUS SILICA SYSTEMS

These materials can be functionalized and are of large interest in different technological fields, for catalysts, as adsorbents, for fixing bioactive molecules such as enzymes and drugs, and as hard template or fillers.



Green Chem., 2012,14, 1884-1887



New J. Chem., 2012,36, 2094-2100



Nanoscale, 2011,**3**, 2801-2818

MESOPOROUS SILICA STRUCTURES

Different structures have been suggested, constituted by SiO₂ walls of specific thickness and porosity

Cellular Foam



Chem. Mater. 2000, 12, 686-696

2D hexagonally ordered



Phys. Chem. Chem. Phys., 2008,10, 347-360

MESOPOROUS SILICA STRUCTURES (TEM)



MCM-41 (2D hexagonal)

V. Meynen et al., Micropor. Mesopor. Mat. 2009, 125, 170-223





MSU-H (large pore 2D hexagonal) Porous walls

Seong-Su Kim et al. Chem. Commun., 2000, 17, 1661-1662

MSU-F (cellular foam)

Commercial mesoporous materials (Sigma Aldrich)



MCM41

2D hexagonal type unit cell of 4.5-4.8 nm pore size of 2.1-2.7 nm specific surface ~1000 m²/g



POWDERS

MSU-H

2D hexagonal type

unit cell of ~11.6 nm pore size of ~ 7.1 nm specific surface ~750 m²/g



MSU-F

cellular foam

unit cell of ~22 nm cell window of ~15 nm specific surface ~562 m²/g





Applicazioni non ottiche Alta purezza → wafer polishing Grande superficie specifica → applicazioni catalitiche Adattabilità → coating, rivestimenti Applicazioni ottiche-elettroniche fibre → preforme alta purezza lenti → omogeneità, modellabilità semiconduttori → film sottili per dispositivi

Quantum computing \rightarrow Quantum dots





Micropatterning detail (scale: 2 µm)

Invarianza delle proprietà fisiche dei materiali durante il loro utilizzo:

Esposizione alla radiazione ionizzante (UV, raggi X, raggi γ)

Applicazioni in ambienti radioattivi o in applicazioni spaziali (lenti, fibre, strati isolanti nei MOS)

Investigazione delle strutture microscopiche che danno luogo a specifiche proprietà:

- Sensibilità-resistenza alla radiazione
- Centri di colore per applicazioni fotoniche: FBG, Laser, dispositivi non lineari
- Difetti di punto in applicazioni elettroniche

Difetto di punto = distorsione a livello atomico della silice



Difetto di punto = comparsa di livelli energetici nella regione di energie proibite

Effetti causati:

Perdita di trasparenza con assorbimento ed emissione di luce

Possibilità di intrappolare cariche con modifica delle proprietà elettriche



livelli energetici dovuti ai difetti

Studio "microscopico" del SiO₂

Effetti della radiazione ionizzante

(Laser, raggi X, raggi γ, raggi β,...) generazione di centri di colore





Determinazione delle strutture atomiche e dei processi di formazione dei centri di colore

Tecniche: Spettroscopia Ottica





Tecniche: Spettroscopia Ottica

Laser UV-visibile, Emissione risolta in tempo



Spettroscopia Raman, Micro-Raman





Tecniche sperimentali

Misure fino a -270°C (bassa temperatura)



Risonanza di spin elettronico





Conclusioni

> Il biossido di silicio seppur un materiale di "vecchia data" costituisce ancora un sistema di avanguardia nella fotonica e nell'elettronica.

> Le novità riguardano applicazioni di materiali di nuova sintesi o sistemi basati su SiO_2 .

> Sono in corso ricerche su materiali che possano sostituire l'Si O_2 in alcune applicazioni standard.

> La ricerca sui difetti di punto mira a Chiarire gli aspetti microscopici che da un lato contrastano l'applicabilità del SiO_2 e dei suoi sostituti, mentre dall'altro sono alla base delle nuove applicazioni (FBG, Fiber Lasers, nanoscristalli).